

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于单个募投项目节余资金永久补流及 部分募投项目变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 已完成募投项目名称：半导体湿法清洗设备扩产项目
- 已完成募投项目结余募集资金的金额和投向：节余资金 5,746.98 万元，永久补充公司流动资金
- 拟变更募投项目名称：半导体晶圆再生二期项目
- 拟募投新项目基本情况：单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目，总投资额 67,264.00 万元，本项目基于公司现有 半导体湿法设备的研发及生产的技术积累，将针对更先进制程工艺节点的高阶单片湿法工艺模块、单片式腔体及耐腐蚀性、高精密度的核心零部件进行研发及产业化，本项目建设期为 36 个月，预计于 2026 年 11 月建设完成。
- 变更募集资金投向金额：本次涉及变更的募集资金总额为 36,202.88 万元，占 2020 年非公开发行股份募集资金总额的 26.70%。
- 风险提示：变更后的募投项目可能会受到国际形势、行业发展等因素的影响，项目实施后效益不达预期等风险，敬请投资者注意风险。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过《关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变更的议案》。公司结合目前 2020 年非公开发行股份募集资金投资项目的进度情况，拟将募投项目“半导体湿法清洗设备扩产项目”节余的募集资金永久补充流动资金；拟将募投项目“半导体晶圆再生二期项目”变更为新项目“单片湿法工艺模组、核

心零部件研发及产业化项目”。该事项尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

一、募集资金的基本情况

2020年11月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3020号）的核准，公司非公开发行不超过78,005,377股新股，截至2020年12月23日，公司本次非公开发行人民币普通股47,749,661股，发行价格28.79元/股，实际募集资金总额为人民币1,374,712,740.19元，扣除各项不含税发行费用人民币20,184,669.49元后，募集资金净额为人民币1,354,528,070.70元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月23日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》[众会字（2020）第8380号]。

公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。

二、募集资金的使用情况

截至2023年9月30日，公司2020年非公开发行股份募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额	累计投入募集资金金额	投入进度
1	半导体湿法清洗设备扩产项目	40,000.00	25,500.00	19,859.84	77.88%
2	半导体晶圆再生二期项目	60,000.00	38,471.27	2,293.21	5.96%
3	光电子材料及器件制造基地建设	67,000.00	31,000.00	17,435.68	56.24%
4	补充流动资金或偿还债务	55,500.00	40,600.00	40,461.01	99.66%
	合计	222,500.00	135,571.27	80,049.74	59.05%

三、单个项目募集资金使用和节余情况

“半导体湿法清洗设备扩产项目”募集资金主要用于单片式和槽式清洗设备进行扩产和技术升级，目前启东半导体装备产业化基地二期已建设完毕并投入使用，上述项目已实施完毕。因公司在设备采购过程中，积极通过采购比价、

供应链管理等手段有效地控制成本，在项目达到可使用状态的情况下，“设备购置及安装”项目实际投入比计划节约超过 20%，费用估算差异节余 5,746.98 万元，拟全部用于永久补充公司经营所需的流动资金。

四、变更部分募投项目的基本情况

1、拟变更募投项目基本情况

本次拟变更的募投项目为“半导体晶圆再生二期项目”，2020 年在当时晶圆再生市场需求旺盛的情况下，本项目计划在原晶圆再生一期项目的基础上，通过扩建厂房、增置设备、新增人员等举措，以进一步扩充晶圆再生项目产能，从而满足市场需求增长，提高公司盈利能力。项目建设地点为安徽省合肥市。

2、原项目计划投资和实际投资情况

“半导体晶圆再生二期项目”募集资金计划投资金额为 38,471.27 万元，截至 2023 年 9 月 30 日，“半导体晶圆再生二期项目”累计投入金额 2,293.21 万元，募集资金投资进度为 5.96%。截至本公告披露日，尚未使用募集资金金额为 36,202.88 万元。

3、变更募投项目的原因

公司原计划于 2021 年在合肥新站工业物流园内建设半导体晶圆再生二期项目。2021 年至今，一方面受外部国际环境和产业背景影响，国内晶圆厂产线的设备总体稼动率不足，使得国内晶圆再生业务的总体市场规模增长受限；另一方面，近两年来多家国内企业开始涉足该领域，市场价格逐渐下行，竞争趋于激烈。经过管理层深入且审慎的评估，认为继续投资该业务板块可能存在投资回报率偏低、利润提升有限的情况，故变更募投项目。

4、公司 2020 年非公开发行股份募集资金投资项目变更前后情况如下：

序号	变更前项目名称	变更后项目名称
1	半导体湿法清洗设备扩产项目	半导体湿法清洗设备扩产项目
2	半导体晶圆再生二期项目	单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目
3	光电子材料及器件制造基地建设项目	光电子材料及器件制造基地建设项目
4	补充流动资金或偿还债务	补充流动资金或偿还债务

五、新项目的情况说明

1、项目概况

新项目名称：单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目

本项目基于公司现有湿法设备的研发及生产的技术积累，将在上海实施土地建设、搭建新产线针对更先进制程工艺节点的高阶单片湿法工艺模块、单片式腔体及耐腐蚀性、高精密度的核心零部件进行研发及产业化。项目有助于满足高阶工艺节点的需求，提升在高深宽比条件下的湿法工艺模块研发能力，实现整机产品在更先进制程的逻辑芯片及高密度存储芯片的制造应用；本项目有利于提高公司半导体核心零部件研发水平，为将来自主生产奠定研发基础；有利于巩固公司在国内的半导体湿法设备及关键零部件行业领先地位。

本次项目建成后将成为公司高阶制程单片湿法装备及零部件研发与产业化基地，在设计、制造及研发上实现从成熟制程往高阶先进制程的路径，装备与核心零部件将形成双向协同，项目达成后将进一步提高生产规模和产品产能，是公司战略目标达成的重要支撑。

项目建设地点为上海市。项目建设期为 36 个月，预计于 2026 年 11 月建设完成。

2、项目必要性分析

(1) 本项目有助于公司对高阶半导体湿法设备核心零部件研发，提升公司市场竞争力

在高阶半导体湿法设备产品中，公司在充分考虑成本效益的基础上，考虑零部件、材料的重要性与优先级，从高阶单片湿法工艺模块、系统集成及支持设备零部件领域切入，旨在研发先进制程工艺的高阶半导体湿法工艺模块、单片式腔体、高纯度阀等。项目拟研发零部件及模块产品完全适用于更先进制程的逻辑芯片及高密度存储芯片的制造工艺及产业化，大力推动单片式腔体在国内的发展，项目建成后，将进一步巩固公司半导体湿法设备行业领先地位，增强公司在高阶半导体湿法设备制造领域的市场竞争力。

(2) 本项目有助于顺应芯片工艺节点发展趋势，提升在高深宽比条件下湿法工艺模块的技术研发能力

芯片制造的技术发展一直是半导体湿法设备发展的驱动力。为了进一步提高集成电路性能，制造工艺升级使得芯片结构越发复杂，从而使得清洗难度升级。随着芯片结构开始 3D 化，此时湿法设备在清洗晶圆表面的基础上，还需在无损情况下清洗其内部污染物，这对清洗设备提出了更高的技术要求。芯片工艺的进步及芯片结构的复杂化也将驱动清洗设备的价值持续提升。

本项目目标主要是顺利实现高阶半导体湿法设备工艺模块的研发及产业化。项目实施是公司顺应芯片制造技术发展，满足客户先进制程工艺节点需求，推动芯片制造过程中高和极高深宽比清洗工艺技术研发水平，保持公司在半导体清洗技术方面行业领先的重要举措。

(3) 项目有助于贯彻落实公司发展战略降低经营风险，寻找新的盈利增长点

公司立足半导体产业，近年来坚定持续地以用户需求为导向进行投入，和半导体产业用户共同成长。公司在战略实施上，重点打造湿法工艺联合实验室，和用户、大学一起开发集工艺、装备、材料一体化的特殊清洗工艺的系统解决方案。公司未来将重点放在持续投入新机型研发与工艺技术提升，满足对不断向前衍进的制程节点对设备技术的更高要求，降低技术迭代带来的经营风险。同时，将保持并巩固提高对成熟机型的市占率优势，实现产能爬坡与毛利率提升。为实现战略发展目标，公司决定实施本项目来进行先进及成熟单片湿法工艺模块、及其核心零部件的研发及产业化，降低未来经营风险，并寻找公司未来新的盈利增长点。

3、项目可行性分析

(1) 项目符合国家和建设地半导体相关产业政策

半导体产业是信息技术产业的核心，是国民经济社会发展的支柱企业，也是涉及国家安全的战略性新兴产业，多年以来一直受到我国政府的大力支持。同时，国家和上海当地一直在鼓励加快推动产品创新和产业化升级，提升产品质量和核心竞争力。近几年政府从税收、资金等各个维度对半导体产业给予扶持，并对半导体设备产业提出了明确的发展目标要求。此外，募投项目实施地点上海市在扶植半导体方面也出台了相应政策。国家及地区有关半导体产业的一系列

产业政策为本次募投项目的顺利实施提供了有力的政策支持保障。

(2) 公司多年积累的技术积淀及研发经验为项目研发的展开提供了充分的保障

公司近年投入众多资源进行自主研发，已经具备了一定的湿法工艺系列的设备研发生产能力（包括湿法去胶、刻蚀、清洗、刷洗），已经切入一线用户的高阶工艺应用，完全覆盖晶圆制造中包括先进制程逻辑电路、高密度存储、化合物半导体特色工艺等多个细分领域的市场需求。目前公司走过了知识产权自主和设备制造自主的阶段，正进入产能爬坡和供应链自主的发展阶段；对于更先进制程工艺需求的进阶功能的研发，也都在有序进行中。

公司始终鼓励创新，重视研发工作，高度重视并始终保持高水平研发投入，坚持技术创新，保证公司产品的技术先进性。公司围绕通用湿法设备领域已经形成了丰富的自主知识产权。

(3) 本土晶圆厂建设的持续加快和先进制程及技术节点的进步，释放了先进高阶半导体湿法设备及湿法工艺模块的巨大市场需求

芯片制造的技术及工艺发展一直是半导体湿法设备发展的驱动力，从而释放先进高阶制程半导体湿法设备等产品的巨大需求。清洗步骤数量约占芯片制造工序步骤的 30% 以上，是芯片制造工艺步骤中占比最大的工序。随着芯片技术节点的不断进步，对于设备工艺及技术的要求在不断提高，清洗工序的数量和重要性也将大幅提高，在实现相同芯片制造产能的情况下所需的清洗设备数量也将持续增长，给先进高阶制程清洗设备带来了巨大的新增市场需求。同时，湿法工艺模块是湿法设备的重要组件，随着清洗设备的市场规模增长，将进一步带动湿法工艺模块的需求量。

(4) 公司多年积累的高端客户和合作伙伴以及持续增长的产品订单，为项目研发目标明确了方向

公司通过多年的经验积累和技术开发，产品和服务不断完善，在行业中形成了良好的口碑和信誉，积累了一批高端客户和合作伙伴，且基本为各自行业的领军企业或主要企业。

目前公司湿法设备已经切入国内一线用户，均为所在下游行业的领先者。其中公司单片湿法设备获得国内重要用户的多个订单，高温硫酸、晶背清洗、后段去胶、长膜前单片机型入选。公司高阶单片湿法设备和槽式湿法设备参与高端清洗设备市场的竞争，公司首批单片湿法设备交付并多工艺顺利通过验证。

基于公司在成熟制程湿法设备等产品上的长期稳定客户积累，可以帮助公司深入了解客户对单片湿法工艺模块、核心零部件的技术要求，从而明确了项目的研发方向，推进公司在高阶湿法设备的研究与产业化，并满足国内高端客户在未来的进阶需求。

(5) 业界领先的差异化技术和优质的研发团队是产品顺利研发的基石

公司所处的半导体专用设备行业集中度高、对外竞争激烈。公司长期坚持差异化竞争和创新的发展战略。目前，公司量产的半导体高阶湿法设备已获得客户认可。此外，公司高阶单片湿法设备和槽式湿法设备的相关技术，能够覆盖包括晶圆制造、先进封装等下游领域的市场需求，以其差异化的技术在业界领先。

另外，公司拥有众多行业专家人才，该等人员大都拥有相关领域全球领先企业的多年从业经历，技术实力强、管理水平高。公司通过提供良好的平台，促使专业人才充分发挥其研发创新经验、生产经验和企业管理经营经验。通过多年在行业内的深耕，大规模培养了国内湿法工艺装备专业团队，实现设备的自研、自产。公司兼顾现有主营业务及外延发展，拥有一支专业度高、技术能力强的核心人才队伍。未来将形成以研发为驱动，全系列自主创新的模式，率先突破更先进制程的湿法设备的研发，进一步提高行业壁垒，奠定国内专业湿法设备供应商的领先地位。

4、项目投资概算

本项目总投资为 67,264.00 万元，本次拟变更募投项目投入的募集资金为 36,202.88 万元。

5、项目经济效益分析

本项目全部达产后预计可实现年均销售收入 7.2 亿元，项目投资回报良好。

6、项目实施主体

本项目拟由上海至纯洁净系统科技股份有限公司负责实施。

7、项目审批情况

项目已取得上海市闵行区经济委员会出具的《上海市企业投资项目备案证明》（项目上海代码：31011270304179X20221D2308003）。

8、风险提示

（1）行业发展变化的风险

公司下游为泛半导体领域尤其是集成电路行业的客户，下游行业投资的周期性波动、行业竞争格局等变化对公司的产品需求、设备销量等造成直接影响，从而导致公司业绩波动。

（2）募投项目实施后项目效益不达预期的风险

公司募集资金用于“单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目”，募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对未来市场趋势的预测等因素制定的，而项目的实施则与国际环境、市场供求、行业竞争、技术进步等情况密切相关，其中任何一个因素的变动都会直接影响项目的经济效益。如果外部环境发生重大不利变化，募集资金投资项目可能无法实现预期收益。此外，由于项目存在一定的投入期，可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险，公司会在项目实施过程中加强资金使用的监督管理，合理安排资金使用，做好内部资金调度，保证项目按时实施和运营。

（3）财务风险

上述项目的投资建设和运营可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，确保项目顺利实施。

（4）国际形势变化的风险

公司所处的半导体行业为涉汲国家安全的战略性产业，受复杂多变的国际形势影响，公司下游客户的产线进展可能会受到制约，进而影响公司产品销量。

六、本次单个募投项目节余资金永久补流及变更部分募投项目对公司的影响

本次单个募投项目节余资金永久补流及变更部分募投项目是公司结合市场环境根据自身主营业务发展做出的合理战略调整，变更前后的募投项目均围绕公司的主营业务，有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。

七、审议程序

2023年12月7日公司召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过《关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变更的议案》，同意将募投项目“半导体湿法清洗设备扩产项目”节余的募集资金永久补充流动资金，将募投项目“半导体晶圆再生二期项目”变更为新项目“单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目”，独立董事和保荐机构发表了同意的意见，该事项尚需提交股东大会审议。

八、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次单个募投项目节余资金永久补流及变更部分募投项目的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意本次对单个募投项目节余资金永久补流及变更部分募投项目的事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次对单个募投项目节余资金永久补流及变更部分募投项目的事项是根据项目实际情况作出的谨慎决定，符合公司的实际情况和长远发展的需求。单个募投项目节余募集资金由于该项目已完成，节余募集资金永久补充流动资金；部分募投项目变更事项，符合公司市场环境变化和公司实际情况，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，本次变更不存在损害股东利益的情况；本次事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。我们同意本次对单个募投项目节余资金永久补流及变更部分募投项目的事项，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，国泰君安证券认为：公司单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变更事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。保荐机构对公司单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变更事项无异议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日